

# 北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年4月24日)

证券代码：688291

证券简称：金橙子

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）_____电话会议_____ |
| 时间、地点及参与单位名称  | 时间：2024年4月24日<br>线上形式：电话会议<br>参与单位：华夏基金、国寿安保基金、阳光保险、天治基金、鑫元基金、兴业基金、申万菱信、圆信永丰、中加基金、昊泽致远、中银资管、中信建投自营、华龙证券、海通资管、上海信托、广汇缘、煜德投资、三亚鸿盛、正圆投资、誉辉资本、紫阁投资、融创智富、山岳私募基金、东兴证券、瓴仁投资、上海晨燕资管、山西证券、东方基金、百年保险资管、摩根资管、泰信基金、西部利得、人保基金、长江证券、东北证券、中泰证券、华创证券  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理 吕文杰<br>董事 程鹏<br>副总经理、董事会秘书 陈坤<br>证券事务代表 高瞻  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <b>一、公司2023年及2024年一季度主要情况介绍</b><br><br>收入方面，公司2023年实现营收2.2亿，同比增长11%。其中，激光加工控制系统业务实现收入1.5亿，同比增长4%，占全部收入70%，毛利率维持在71%；系统集成硬件业务收入约4000万，同比增长32%，其中振镜产品进入小批量销售阶段；激光精密加工设备业务实现收入约2500  |

万，同比增长 24%，主要因调阻业务快速增长所致。

净利润方面，公司综合毛利率 59%。期间费用有所增加：研发费用率 25%，同比增长 3pct，由于研发人员数量增加导致薪酬增加以及相关研发投入增加所致；销售费用率 12%，同比增长 3pct，由于公司加大市场推广力度；管理费用率 14%，同比增长 1pct，主要由于对 24、25 年可能实现的股权激励计划，在 23 年分摊计提了股份支付费用所致。2023 年实现归母净利约 4200 万，同比增长 8%，扣非归属于母公司净利润约 2800 万，同比下降 24%。

现金流方面，经营活动现金流净额同比增长 13%。

从科创属性看，公司硬科技含量的纯度在提高。研发费用率 25%，研发人员占比 38%，报告期内知识产权数量再创新高。2023 年内新增授权专利 35 项、软著 26 项。同时在积极拓展高端应用领域，如硅片划线、圆盘飞行清洗、焊接、玻璃切割钻孔、无限视野联动等。

2024 一季度，公司实现收入 4,948 万，同比增长 3%，净利润近 692 万，同比下降 43%，扣非净利约 500 万，同比下降 40%，由于公司人员数量增加致薪酬增长及计提股权激励的股份支付费用所致。

## **二、公司前期研发投入较多，也在新领域做了较多布局。未来哪些领域能够取得突破，给业绩带来增幅？**

振镜产品方面。募投项目投入大量研发资源，今年有望取得突破，主要是应用在 3C 消费电子、脆性材料、新能源等领域。

振镜控制系统方面。主要突破飞行焊和无限视野两个方向。无限视野的应用领域较广，目前在汽车、3C、PCB 等领域做前期验证，一季度以来已和行业客户不断接触；飞行焊主要用于汽车、新能源行业，对产品稳定性要求很高，验证和导入周期相对较长，初步规划要到三季度后能逐步带来收入。

伺服控制系统方面。今年也会逐步开始放量。

## **三、今年一季度的业务拆分以及各业务毛利率变化情况？**

一季度来看，激光加工控制系统、激光系统集成硬件、激光精密加工设备三块业务整体收入分布相比 2023 年度变化不大。

激光加工控制系统整体毛利率略有上升，主要因中高

|              |  |
|--------------|--|
|              | <p>端控制系统销售占比有所上升；激光系统集成硬件包括振镜及部分联调联试的其他硬件，振镜产品目前处于小批量生产阶段，毛利率不太稳定，振镜量产后毛利率目标做到30%左右；激光精密加工设备的毛利率约45%，也是同比有所上升。</p> <p><b>四、高等院校产业链合作有什么具体案例？合作模式是怎样的？</b></p> <p>目前有和高校联合开发五轴振镜产品，主要应用于航天航空中的细毛孔等各种异形精密孔的加工。</p> <p>公司产品主要面向激光微加工领域，与高校合作主要选择和精密微加工相关的研究方向。软件主要是公司自主开发，但光学层面的设计等工作是高校完成。</p> <p><b>五、公司公告作废了2023年股权激励部分股份，对股份支付费用的影响？</b></p> <p>公司2023年未能达到股权激励目标，相应2023年部分的股份支付费用进行冲回，目前确认的360多万股份支付费用是考虑24、25年可能实现的股权激励计划，在23年分摊计提了股份支付费用所致。</p> <p><b>六、公司持续进行人员扩展特别是研发人员，请问下公司后续在人才及费用方面的规划？</b></p> <p>在过去新产品推进过程中，公司发现了不少需要继续攻关的技术难点，为了加快新产品研发力度，对研发人员的投入力度相对比较大。</p> <p>对科技公司来讲，人才是第一位的。不管是软件还是硬件都需要大量研发人员。公司会抓住市场变动机遇，招揽优秀的研发人员。</p> <p>目前公司在研发人员方面做一些调整，会更注重研发和收入转换效率，这也是组织管理方面需要下功夫的地方。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无  |